

**Publication number : 62-054228**

**Date of publication of application : 09.03.1987**

---

**Int.Cl. G02F 1/133 G02F 1/13 G09F 9/35**

**5**

**Application number : 60-155836**

**Applicant : SEMICONDUCTOR ENERGY LAB CO LTD**

**Date of filing : 15.07.1985**

**Inventor :**

**10 YAMAZAKI SHUNPEI**

**KONUMA TOSHIMITSU**

**HAMAYA TOSHIJI**

**MASE AKIRA**

**KOYANAGI KAORU**

**15 IMATO SHINJI**

**YAMAGUCHI TOSHIJI**

**SAKAMA MITSUNORI**

**INUSHIMA TAKASHI**

---

**20 MEHTOD FOR FABRICATING LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE**

**[Abstract]**

**PURPOSE:** To execute filling work of the liquid crystal for a short time by decreasing the temperature of a substrate where a thin FLC is charged and laminated, after the substrate is preserved to the room temperature,

executing sealing by a plastic agent for sealing the peripheral part.

**CONSTITUTION:** An equal pressure is applied to the whole surface of a pair of substrates, and the liquid crystal is extended along the surface of a substrate 1 in the horizontal direction and laminated. The heater is gradually 5 dropped to the room temperature, further, the first space 5 is also made into the air pressure, a cover 10' of a vacuum container 100 is removed, and the cell to laminate the liquid crystal between a pair of substrates is removed from the container. Thus, two facing substrates 1 and 1' are made into the condition to overlap mutually essentially a liquid crystal 3. Further, the 10 substrate is reheated in accordance with the necessity, a sealing agent 9 for sealing is applied at the peripheral part and the mutual substrate is fixed.

## SPECIFICATION

### 1 Title of the invention

MEHTOD FOR FABRICATING LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE

5

### 2. Claims

1. A method for fabricating a liquid crystal display (LCD) device having a liquid crystal cell in which each of a pair of bases with an electrode are installed facing each other and smectic liquid crystals are charged between the electrodes, wherein after the smectic liquid crystals are charged between the electrodes of the substrates, an edge portion of the pair of substrates is sealed.

2. The method of claim 1, wherein the smectic liquid crystals are ferroelectric liquid crystals.

3. The method of claim 1, wherein a gap between the electrodes is 4 $\mu$ m or below.

### 20 3. Detailed description of the Invention

#### [Field of the Invention]

The present invention relates to a method for fabricating a liquid crystal display (LCD) device and, more particularly, to a method for fabricating an LCD device capable of making a display part of a microcomputer, a word process or a TV set thin by installing a display panel

using smectic liquid crystals (referred to hereinafter as 'Sm liquid crystals' or 'liquid crystals'), especially, for example, ferroelectric liquid crystals (referred to hereinafter as 'FLC').

5 [Description of the Prior art]

A solid display panel is effective for a large-scale display panel in controlling each pixel independently. As the solid display panel, a display device which employs a multiplexing driving method with a simple matrix structure of A4 plate size with horizontal 400 elements and vertical 200 elements by using 2 frequency liquid crystals, for example, twisted/nematic liquid crystals (referred to hereinafter as 'TN liquid crystals'), is widely known.

However, in fabricating the TN liquid crystals, since the TN liquid crystals has a low viscosity, when a pair of glass substrates are bonded, the 15 glass substrates are placed to face with an interval of  $5\mu\sim10\mu$  therebetween and then a sealant mixed with spacers is coated on an edge portion of the glass substrates to bond them. In this case, a portion of a seal portion of the edge portion is not sealed but remains as an opening. Thereafter, the pair of substrates with their edge portion sealed is maintained in a vacuum 20 container and entirely vacuumized. And then, the opening is put in a TN liquid crystal solution and the interior of the vacuum container is allowed to have an atmospheric pressure in order to charge liquid crystals into the gap of  $5\mu\sim10\mu$  between the substrates by using a capillary phenomenon.

25 [Problems to be solved by the Invention]

Such method is good when liquid crystals with the low viscosity such as the TN liquid crystals are charged between the substrates at a room temperature, but has many disadvantages in the following aspects.

That is, first, the method cannot be suitably employed in terms of its 5 operation for the smectic liquid crystals with high viscosity, for example, the FLC which uses an SmC\* layer.

Second, when the FLC is used on the premise that a gap between electrodes of a cell is  $4\mu$  or less, preferably, as narrow as  $0.5\mu\sim 3\mu$ , it takes much time to charge the FLC.

10 Third, when the FLC is charged on a large-scale plate, for example, on the A4 plate, it take long time, namely, 8 to 10 hours, at a high temperature, i.e.,  $120^{\circ}\text{C}$  for charging the FLC. Thus, sealing of the edge portion can be degraded. In addition, the sealant can be mixed as an impurity into the liquid crystals.

15 Fourth, spacers (generally called 'scallop') which determine the cell gap can be inclined during the process of charging the liquid crystals.

Fifth, 90% of the liquid crystal material is not effectively used during charging, resulting in a waste of liquid crystals.

The present invention solves these problems.

20

#### [Means for solving the problem]

To achieve these and other advantages and in accordance with the purpose of the present invention, as embodied and broadly described herein, there is provided a method for fabricating an LCD device by using a so-  
25 called lamination method in which liquid crystals are put on one substrate,

the other substrate is allowed to be tightly attached on the liquid crystals, the two substrates are mutually installed at a certain position. At the same time or in a follow-up process, sealing is made on an edge portion.

In addition, in the present invention, the smectic liquid crystals, and  
5 preferably, FLC having a smectic C phase (SmC\*), are used. Namely, by making the cell gap 4 $\mu$ m or below, and generally, 0.5 $\mu$ m~3 $\mu$ m, a (both-side) stable state can be obtained.

That is, (isotropic) liquid crystals are dropped, spread or are coated at one or plural spots on a charge-subject surface of an electrode of one  
10 substrate, the other substrate is placed thereon.

The substrates are vacuumized and heated at their front and back side, pressed, and tightly attached respectively with FLC with the charge-subject surface installed on the inner side of each substrate with gap of 4 $\mu$ m or below therebetween. A temperature of the substrate on which the FLC has  
15 been charged and laminated is dropped to obtain an SmA and also a (both-side) stable SmC\*. Then, a spiral structure can be released. And then, the substrates are maintained at a room temperature and sealed with a practical plastic sealant at their edge portion.

In the present invention, as for a usage temperature range, namely,  
20 the remaining problem, currently, a plurality of different FLCs can be combined (blended) and used at 0°C~50°C. Thus, the FLC can be practically used. And, referring to grey, if 8 colors are considered, the grey is not necessary, and it can be practically used for a display such as a microcomputer.

### [Operation]

Accordingly, first, because a minimum cell gap is determined according to a size of spacers after spreading them, there is no non-uniformity in the gap of the formed FLC.

5 Second, even if the cell is thin with a gap of 4 $\mu$ m or below and has a large area (equivalent to A4 plate), the lamination operation can be preformed quickly.

Third, the FLC placed on the substrate can be effectively used by 100%.

10 Fourth, with the FLC with high viscosity, the lamination and sealing operation does not require one or more hours.

15 Fifth, even if an active device and an electrode connected with the active device are installed on one substrate, the FLC can be laminated in the same manner as a process of a passive structure which does not use the active device.

With such characteristics, in the present invention, the liquid crystal laminating method (which means narrowing the gap between the two sheets of substrates and putting the laminated liquid crystal therebetween) is employed, and the nonlinear element (NE) and the FLC are made in series to 20 form each pixel, thereby obtaining a large-scale of A4 plate or larger matrix and driving each pixel without a cross talk therebetween.

### [Embodiment of the invention]

Figure 1 illustrates a process of fabricating an LCD device in 25 accordance with the present invention.

Figure 1A shows two substrates 1 and 1'. The substrates 1 and 1' have an electrode at the mutually facing surfaces 8 and 8' thereof. In order to display color, a color filter is installed between one electrode and the facing substrate or between one electrode and charge liquid crystals. And, as 5 widely known, an asymmetrical alignment is performed on the surface of the electrode.

Though the two substrates are simply shown for the sake of simplification, the electrode, the filter, alignment processing, shadow processing (masking) for obtaining black matrix, and an active device can 10 be formed or performed as necessary.

As the substrates, a glass substrate, e.g., a coning 7059, is generally used. And, among two substrates, one substrate or both substrates can be a flexible substrate. As the flexible substrate, a chemically strengthened glass substrate with a thickness of 0.3mm~6mm or a light transmissible heat-resistant organic resin substrate such as polyimide, PAN or PET can be also 15 effectively used.

An alignment processing layer (asymmetrical alignment processing layer) is formed on the electrode of the substrate, and its surface is subject to be charged. And then, the FLC, e.g., S8 (octyl, oxy, benziriden, amino, 20 methyl, butyl, benzoate), is installed on the surface. Besides, an FLC such as BOBAMBC or an FLC obtained by blending a plurality of types of liquid crystals can be charged. Herein, for example, liquid crystal obtained by blending S8 and B7 is used.

In addition, liquid crystals 2 are dropped on the charge-subject 25 surface of one substrate. The pair of substrates with the liquid crystals

installed therebetween are sealed in a vacuum container 100. The vacuum container 100 includes a first space in a container side 10 and a second space 5 in a cover side 10'. A heater 3 is installed in the first space 4. One substrate 1 is installed on the heater 3 and heated at a room temperature or  
5 at a certain temperature within 150°C, for example, at 70°C~150°C, e.g., 120°C, at which viscosity of the liquid crystals becomes sufficiently low.

Then, the liquid crystals 2 installed on the substrate 1 are heated. Before or after the liquid crystals were dropped to be placed, spacers are installed on the substrate with a certain gap. The spacers cannot be used.  
10

The other substrate 1' facing the substrate 1 is disposed to be separated by 1mm~10mm such that they partially contact with each other lightly.  
15

Thereafter, the cover container 10' having the second space 5 is adjusted to the container 10 by means of an O ring. The lower portion of the second space is shielded by a layer (called a silicon rubber 6) with elasticity with respect to the second space. As for a pressure of the second space and the first space, if the pressure of the first space has a positive pressure, the lower side is expanded, whereas if the pressure of the first space is a negative pressure, the rubber 6 is pulled up. The rubber is not limited to the silicon rubber so long as it can tolerate at least the temperature of 150°C.  
20

After they are adjusted by the O ring, they are simultaneously vacuumized at the outlets 11 and 11'. Namely, the two outlets are connected with a vacuum pump 14 after passing through valves 12 and 12'. The first and second spaces 4 and 5 are vacuumized by opening the valves 12 and 12' and  
25 closing valves 13 and 13'.

And then, as shown in Figure 1C, the other substrate is precisely installed on the surface of the substrate.

Thereafter, air or nitrogen is leaked gradually from the valve 13' so as to make the second space 5 have a positive pressure, compared with the 5 first space 4, and obtain and the atmospheric pressure.

Then, as shown in Figure 1C, the silicon rubber 6 expands downwardly to press the other substrate 1' toward the substrate 1. In the atmospheric pressure, pressure of  $1\text{kg}/\text{cm}^2$  can be applied. In case of giving more pressure by using nitrogen, pressure of 1 or more and  $2\sim 5\text{kg}/\text{cm}^2$  can 10 be applied.

In this manner, the uniform pressure can be applied to the entire surface of the pair of substrates, which makes liquid crystals which have been placed at one or more spots spread on the surface of the substrate 1 in the horizontal direction, so as to be laminated.

15 The gap between electrodes of the pair of substrates can have the uniform thickness of  $4\mu\text{m}$  or less, e.g.,  $2\mu\text{m}$ . If a spacer with a size of  $2\mu\text{m}$  is previously installed, the thickness of the gap can be  $2\mu\text{m}$ , and if spacers of  $1\mu\text{m}$  spread in advance, the thickness of the gap can be  $1\mu\text{m}$ .

As a matter of course, the spacer cannot be used, and liquid crystals 20 can be laminated to a certain thickness by precisely controlling only the pressure and the heating temperature.

As a result, some liquid crystals are moved toward the edge portion. In this case, because the outer edge portion is covered by the silicon cover, overflowing of the liquid crystals outwardly of the outer edge portion of the 25 substrate can be substantially prevented. In addition, overflowing of liquid

crystals beyond the whole edge portion or shortage of liquid crystals for covering a desired region can be prevented by precisely controlling the initial supply amount of liquid crystal material.

As for overlapping of the two sheets of substrates in the X and Y directions, the substrates can be moved to be re-installed when the liquid crystals 3 have low viscosity when it is heated with the substrates 1 and 1'.

Thereafter, the heater was gradually dropped to a room temperature in Figure 1C. In addition, the first space 5 was adjusted to have the atmospheric pressure and the cover 10' of the vacuum container 100 is taken off. A cell obtained by laminating the liquid crystals between the pair of substrates as shown in Figure 1D is taken out. The two sheets of facing substrates 1 and 1' have the liquid crystals 3 overlapped therebetween.

With reference to Figure 1E, the substrates are re-heated as necessary, a sealant 9 (generally, a plastic material) is applied to their edge portion, and then, the substrates are bonded.

In this manner, the method for charging/laminating the liquid crystals with high viscosity like the smectic liquid crystals, especially, the FLC, is implemented between the substrates.

## 20 [Effect of the invention]

Accordingly, the amount of liquid crystals required to be used for one sheet of A4 plate (the area of 20cm x 30cm) can be 0.2cc enough, amounting to 2000 yen/g. That is, the liquid crystals more expensive than gold can be effectively used.

25 A short time, namely, about 1 hour, is taken to perform charging

operation of the liquid crystals one time.

In spite of the large-scale substrate, the operation time cannot be lengthened.

That is, in the related art TN liquid crystal charging operation, the  
5 main interest is focused on not applying a stress to liquid crystals. Thus, the sealant on the edge portion of substrates support mutually with their force so as not to apply pressure, that may be applied from outside to the substrates, to liquid crystals themselves.

In this respect, however, as for the smectic liquid crystals, the  
10 inventors of the present invention have found that an external pressure applied to the liquid crystals does not matter thanks to the high viscosity of the smectic liquid crystals. Thus, such characteristics lead to accomplish the fabrication method of the present invention, which is completely different from any other related arts.

15 In the liquid crystal charging method in accordance with the present invention, the alignment processing layer constituting the charge-subject surface is asymmetrically aligned, namely, one portion is rubbed while the other portion is non-rubbed. In this case, after laminating, the substrates are slightly moved (1 $\mu$  or more to 104 $\mu$ m) in a high temperature state according  
20 to the rubbed surface, and stress is applied to liquid crystals to align them.

As for the LCD device in accordance with the present invention, in case of a reflection type LCD device by installing a polarization plate at an outer side of one substrate or at both outer sides of the two substrates, an electrode at the side of substrate where light is made incident is made to be  
25 light-transmissible while an electrode at the other substrate is made a

reflection type electrode. By having a tilt angle of the FLC as 4.5°, one sheet of filter can be installed on the substrate where light is made incident.

Meanwhile, in case of a transmission type or reflection type LCD device using two sheets of filters, two sheets of polarization plates are aligned at an outer side of each substrate and the tilt angel of the FLC is adjusted at about 22.5°. In the transmission type LCD device, a backlight unit can be irradiated by an EL (Electroluminescence) fluorescent lamp or a natural light, and the amount of transmitted light can be controlled for displaying an image.

10        In case of making color, preferably, a color filter is installed at an upper or lower portion of the electrode of the other substrate (namely, the substrate viewed by naked eyes).

15        In the present invention, a non-linear device is installed on the substrate and an electrode is installed at an upper portion of the non-linear device. Instead of the non-linear device, an active device can be used. As the non-linear device, an SCLAD (Space Charge Limitation Amorphous semiconductor Device) or an insulation gate type field effect semiconductor device having a composite diode structure such as NIN type can be used.

20        In the LCD device of the present invention, a photosensor using a write pen has a dot shape for displaying and reading.

The fabrication process of Figure 1 has a matrix construction of 100x100 (in case of color, 100x300).

However, the number of dots can be 640x400 (in case of color 1920x400) and 720x400, and other number of constructions.

**[Description of drawings]**

**Figure 1 illustrates a method for fabricating a liquid crystal display (LCD) device in accordance with the present invention.**

5

⑯ 日本国特許庁 (JP)

⑮ 特許出願公開

⑰ 公開特許公報 (A) 昭62-54228

⑯ Int.Cl.

G 02 F 1/133  
1/13  
G 09 F 9/35

識別記号

125  
101

府内整理番号

8205-2H  
7448-2H  
6810-5C

⑮ 公開 昭和62年(1987)3月9日

審査請求 未請求 発明の数 1 (全6頁)

⑯ 発明の名称 液晶表示装置の作製方法

⑰ 特願 昭60-155836

⑰ 出願 昭60(1985)7月15日

⑰ 発明者 山崎 幸平 東京都世田谷区北烏山7丁目21番21号 株式会社半導体エネルギー研究所内

⑰ 発明者 小沼 利光 東京都世田谷区北烏山7丁目21番21号 株式会社半導体エネルギー研究所内

⑰ 発明者 浜谷 敏次 東京都世田谷区北烏山7丁目21番21号 株式会社半導体エネルギー研究所内

⑰ 発明者 間瀬 晃 東京都世田谷区北烏山7丁目21番21号 株式会社半導体エネルギー研究所内

⑰ 出願人 株式会社 半導体エネルギー研究所 厚木市長谷398番地

最終頁に続く

明細書

1. 発明の名称

液晶表示装置の作製方法

2. 特許請求の範囲

1. 電極を互いに有する一对の基板を有する面を内側にして対向せしめ、前記電極間にスメクチック液晶を充填した液晶セルにおいて、前記基板の電極間にスメクチック液晶を充填した後、前記一对の基板の周辺部を封止せしめることを特徴とする液晶表示装置の作製方法。
2. 特許請求の範囲第1項において、スメクチック液晶は強誘電性液晶よりなることを特徴とする液晶表示装置の作製方法。
3. 特許請求の範囲第1項において、電極間は4μ以下を有することを特徴とする液晶表示装置の作製方法。

3. 発明の詳細な説明

「発明の利用分野」

この発明は、液晶表示装置の作製方法に関するものであって、スメクチック液晶（以下Sm液晶ま

たは液晶という）特に例えれば強誘電性液晶（以下FLCという）を用いた表示パネルを設けることにより、マイクロコンピュータ、ワードプロセッサまたはテレビ等の表示部の薄膜化を図る液晶表示装置の作製方法に関するものである。

「従来の技術」

固体表示パネルは各絆素を独立に制御する方式が大面積用として有効である。このようなパネルとして、従来は、二層波液晶例えばツウィスティック・ネマチック液晶（以下TN液晶という）を用い、横方向400 素子また縦方向200 素子とするAA判サイズの単純マトリックス構成にマルチプレキシング駆動方式を用いた表示装置が知られている。

しかし、かかるTN液晶を作製せんとした場合、このTN液晶の粘度が低いため、一对のガラス基板を5~10μの間隙をあけて対向せしめ、この一对のガラス基板の周辺部に封止用シール剤をスペースを混合して塗布し、お互いを密着させる。この時周辺のシール部の一部の封止をせず、開穴を残して設けておく。この後この周辺が封止された

(1)

(2)

一対の基板を真空容器内に保持し、全体を真空引きする。さらに、この後この間穴部分をTN液晶溶液中に浸し、この真空容器内を大気圧により、毛細管現象を利用して一対の基板間の5~10μの間の空隙に液晶を充填せんとするものであった。

「発明が解決しようとする問題点」

しかしかかる方法は、TN液晶の如き室温で低粘度の液晶を基板間に充填する場合には優れている。しかし、

- (1) 粘度の高いスマートチック液晶例えばSmC\*底を用いるPLCに対してはきわめて作業がしづらい。
- (2) セルの電極間の間隙を4μ以下好ましくは0.5~3μの狭い間隙を用いることを前提とするPLCを用いる場合、充填にきわめて時間がかかるてしまう。
- (3) PLCを大面積例えればA4版に対し充填せんとする場合、8~10時間もの長時間高温例えれば120℃で充填作業を必要とする。そのため、

(3)

周辺部の封止が劣化しやすい。またこの封止材料が不純物として液晶内に混入しやすい。

- (4) 液晶の充填に伴いセルギャップを決めているスペーサ(通称貝柱)が一方に偏りやすい。
- (5) 充填の際有効に用いられない液晶材料が全体の90%近くになってしまい無駄が多い。

等の多くの欠点を有する。

本発明はかかる問題点を解くものである。

「問題を解決するための手段」

かかる問題を解決するため、本発明は、一対の基板に対し液晶を充填する前に一対の基板の周辺部をシールするのではなく、一方の基板上に液晶を設けた後、この液晶上に他方の基板を密接せしめ、さらに一対の基板を所定の相互位置に配設せしめるものである。さらにこの工程の後工程として、周辺部に封止用シールを行わしめるいわゆるラミネート(薄層にする、薄層にのばすの意)方式を用いることを基本とする。

加えて本発明においては、液晶材料としてスマートチック液晶、特に好ましくはスマートチックC相

(4)

(SmC\*)を呈する強誘電性液晶を用いる。即ちセルの間隔を4μまたはそれ以下一般には0.5~3μとすることにより双安定状態を得ることができる。

即ち、かかる一方の基板の電極上の被充填面上の一点または複数点(等方性)液晶を滴下、散布またはコートし、他方の基板をこの上に配設する。

さらにこれらを真空引きをし、その前後において加熱し、その一対の基板を互いに加圧して、それぞれの基板の内側に設けられた被充填面を4μ以下の間隔にして互いにPLCと密接せしめる。さらにこの薄いPLCが充填されラミネートされた基板の温度を降下させ、SmAを得、さらに双安定なSmC\*を得る。するとらせん構造をとることができる。この後、常温に保存した後、周辺部に対しシール用のプラスチック封止剤による封止を行う。

また本発明でも残された問題点の使用温度範囲は、現在複数の異なるPLCを組合わせて(ブレンドして)-0~50℃において使用が可能となっている。このため実用上はそれほど問題とならず、

(5)

また階調に関してはカラーも8色までとするならば階調が不要であり、マイクロコンピュータ等のディスプレイとしては十分実用が可能であることが判明した。

「作用」

かくすることにより、

- (1) セルはスペーサを散布しその大きさにより最小の間隙を決定するため、形成されるPLCの間隙にばらつきがない。
- (2) 4μ以下の間隙(セル厚)の薄いセルであってかつ被充填面が大面積(A4版相当)であっても短時間でラミネート作業を行うことができる。
- (3) 基板上に設けたPLCを100%有効利用することができる。
- (4) 粘度の高いPLCを用いても、そのラミネートおよび封止の作業に1時間以上を必要としない。
- (5) 一方の基板側にはアクティブ素子とそれに連結した電極を設けても、まったくアクティブ

(6)

素子を用いないハッジブ構造と同一工程でPLCのラミネートができる。

さらに、これらの特徴により本発明の液晶のラミネート（2つの基板の間隙を少しづつ狭くし、その間に液晶を薄層化して介在させることを示す）方法を用い、加えて非線型素子（NE）と強誘電性液晶（PLC）とを直列にして各要素を構成せしめる場合、A4版またはそれ以上の大面積のマトリックス化にそれぞれの要素間のクロストークを除去し駆動させることが初めて成就できた。

以下に実施例に従って本発明を説明する。

#### 「実施例1」

第1図は本発明の液晶表示装置の作製工程を示す。

第1図(A)は2つの基板(1), (1')を有する。この相対向する面(8), (8')側にはそれぞれ電極を有している。またカラー表示をするには、その一方の側の電極と基板との間または電極と充填される液晶との間にカラーフィルタが設けられている。さらにこの電極の上面には公知の非対称配向処理

がなされている。

これらの図面では、簡単にするため図示することを省略して単に基板として表記している。しかし一対の基板の相対向する側にこれらの電極、フィルタ、配向処理、ブラックマトリックス化するシャドウ処理（マスク）の形成、アクティブ素子の作製等を必要に応じて行うことは有効である。

また、基板は一般にはガラス基板例えばコーニング7059を使用する。しかし基板の一方または双方に可曲性の基板を用いることは有効である。そしてその可曲性基板として、化学強化がなされた0.3～0.6mm厚のガラス基板、またはポリイミド、PAN, PET等の透光性耐熱性有機樹脂基板を用いることは有効である。

この基板上の電極上には配向処理層（非対称配向処理層）が設けられ、その上面を被充填面とした。そしてこの面上にPLC 例えばS8C（オクチル・オキシ・ベンジリデン・アミノ・メチル・ブチル・ベンゾエイト）を設けた。これ以外でもBODAMBC等のPLC または複数のブレンドを施したPLC を充

(7)

(8)

壇し得る。例えばここではS8とB7とのブレンドした液晶を用いた。

さらにこの一対の基板の一方の被充填面上に液晶(2)を滴下させた。

かかる液晶が設けられた一対の基板を第1図(B)に示すごとき真空容器(100)に封入した。この真空容器(100)は容器側(10)に第1の空間を有し、蓋側(10')に第2の空間(5)を有する。第1の空間(4)内にはヒータ(3)が設けられている。このヒータ(3)上に一方の基板(1)を配設し、この基板を室温～150℃内の所定の温度、例えば液晶の粘度が十分低くなる70～150℃例えは120℃に加熱制御させた。

すると既に基板(1)上の被充填面に設けられた液晶(3)が加熱される。この液晶を滴下して設ける前または後に所定の間隔をおいて基板上にスペーサを配設させた。このスペーサはまったく用いない方式をとってもよい。

さらにこの上方に対向する他方の基板(1')を1～10mm離間してまたはかるくお互いを部分的に接

せしめて配置させた。

この後、この第2の空間(5)を有する蓋側容器(10')をOリングにより容器(10)側に合わせ込んだ。この第2の空間の下側には、第1の空間と第2の空間とがお互いに弾力性を有する層（以下簡単のためシリコンラバー(6)という）で遮蔽されている。そして第2の空間と第1の空間の圧力において、第1の空間の圧力が正圧の場合は下側を膨脹し、逆の負圧の場合は上側に引っ張られるようになっている。このラバーは少なくとも150℃の温度に耐えることができる材料であれば、シリコンラバーにかぎらない。

これらをOリングにより互いに合わせ込み、(11), (11')より同時に真空引きをした。即ち、この2つの出口は、バルブ(12), (12')を経て真空ポンプ(14)に連結されている。そしてこのバルブ(12), (12')をともに開、バルブ(13), (13')をともに閉として、第1および第2の空間(4), (5)をともに真空空間とした。

さらに第1図(C)に示す如く、この上面に離間

(9)

(10)

している他方の基板を精密に配設した。

この後、他方の第2の空間(5)を真空状態より第1の空間(4)に比べて正圧となるように徐々にバルブ(13')より大気または窒素をリークし大気圧にさせた。

すると第1図(C)に示す如く、シリコンラバー(6)は下側に膨張し、対向する他方の基板(I')を一方の基板(I)の側に押しつける。そして大気圧においては $1\text{kg}/\text{cm}^2$ の圧力を加えることができる。また窒素によりさらに加圧する場合は1気圧以上の $2 \sim 5\text{ kg}/\text{cm}^2$ の圧力とすることも可能である。

かくして一对の基板の全表面に均一な圧力を加えることができ、この圧力により液晶は一点または複数点に点状に設けられていたが、横方向に基板(I)の表面にそって広がり、ラミネートされる。

さらにその一对の基板の電極側の間隙は $4\mu$ 以下例えば $2\mu$ の均一な厚さとすることができる。そしてこの厚さはスペーサが $2\mu$ の大きさのものを予め配設しておくと $2\mu$ となり、 $1\mu$ のスペーサを散布させておく時には $1\mu$ とすることができる

(11)

る。

もちろんスペーサをまったく用いず、この圧力と加熱している温度とのみを精密に制御して所定の厚さにラミネートさせることも可能である。

その結果、液晶の余分のものは周辺部に移動する。しかしこの外周辺をシリコンラバーが覆っているため、これが基板の一端の外側周辺より外側に液晶があふれることを実質的に防ぐことができる。またすべての外周辺より液晶があふれたり、また所望の領域全体を覆うことなく足りなくなったりすることは、初期の液晶の供給量を精密にすることにより防ぐことができる。

2つの基板のおたがいのX方向Y方向の重ね合わせは密着させる基板(I),(I')及び液晶(3)が加熱されている低粘度状態の時に移動させ再配設させることができる。

この後、第1図(C)でヒータを徐々に室温に降下した。さらに第1の空間(5)をも大気圧とし真空容器(100)の蓋(10')を取り外した。一对の基板間に液晶をラミネートさせたセルを容器より取

(12)

り出し第1図(D)を作る。

かくして第1図(D)に示す如く、2つの対向する基板(I),(I')は液晶(3)を互いに実質的に重ね合わせた状態にする。

さらに第1図(E)に示すごとく、この基板を必要に応じて再加熱し、この周辺部に封止用シール剤(9)(一般にはプラスチック材料)を塗布し、お互の基板を固着させる。

かくして、本発明のスマートック液晶の如く、高い粘度を有する液晶、特にPLCの基板間での充填ラミネート方法を確立することができた。

「効果」

かくすることにより、A4版( $20\text{cm} \times 30\text{cm}$ の面積)1枚で使用する液晶は $0.2\text{cc}$ で十分であり、 $3000\text{円}/\text{枚}$ と金より高価な液晶をきわめて有効に用いることができる。

1回の液晶の充填作業を約1時間の短時間で行うことができる。

大面積になっても、作業時間は長くならないという特徴を有する。

(13)

即ち、従来より公知のTN液晶の充填作業においては、この液晶に応力が加わらないようにすることが主である。そのため、周辺部のシール剤はおたがいの基板に外部より加わり得る圧力が液晶それ自体に加わらないよう互いの力を支えている。

しかしスマートック液晶では、この力が液晶それ自体に加わってもその粘度が大きく、差し支えないことを本発明人は見出した。そしてこの特性を利用することにより従来とはまったく異なる本発明の組合せ方法を可能にすることことができた。

以上の本発明の液晶の充填方法において、被充填面を構成する配向処理層を非対称配向処理とし、一方をラビング処理をし、他方を非ラビング処理とする。この時、本発明の如くラミネイトした後、この基板をラビングを施した面にそって高温状態等で微動( $1\mu$ 以上の $1 \sim 10^4\mu\text{m}$ )させ、ストレスを液晶に加え配向せしめることは有効である。

以上に述べた本発明の液晶表示装置において、この基板の一方または双方の基板の外側に偏光板を設け、反射型とする場合は、その入射光側の電

(14)

極を透光性とし、他方を反射型電極とする。そしてFLCのチルト角を約45度とすることにより、1枚のフィルタを入射光側の基板上に配設して実施することができる。

他方、2枚のフィルタを用いて透過型または反射型とする場合は、2枚の偏光板をそれぞれの基板の外側に配向させ、FLCのチルト角を約22.5度とすることにより成り立たせ得る。透光型においてはバックライトをEL(エレクトロ・ルミネッセンス)蛍光灯または自然光により照射し、透光する光の量を調節することによりディスプレイとすることができます。

カラー化する場合は他方の対向基板側(人間の目で見える側)の電極の上側または下側にカラーフィルタを設ければよい。

さらに本発明においては、基板上に非線型素子を配設し、その上方に電極を設けたものを基板として取り扱い、アクティブ素子型とすることができます。かかる場合、この非線型素子としてNIN型等の複合ダイオード構造を有するSCLAD(空間電荷制

限電流型アモルファス半導体装置)、絶縁ゲイト型電界効果半導体装置を用いることが可能である。

本発明の液晶表示装置において、ライトベンを用いたフォトセンサをドット状に作ることにより表示とその読み取りとを行うことができる。

本発明の第1図の作製工程は $100 \times 100$ (カラーにおいては $100 \times 300$ )のマトリックス構成とした。

しかしこのドット数は $640 \times 400$ (カラーの場合)は $1920 \times 400$ ,  $720 \times 400$  その他の構成をも有し得る。

##### 5. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の液晶表示装置の作製方法を示す。

特許出願人

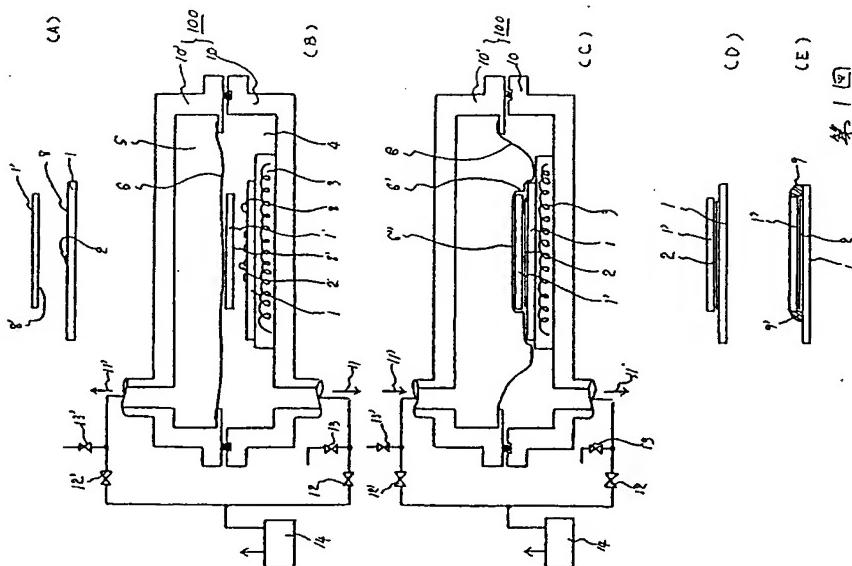
株式会社半導体エネルギー研究所

代表者 山崎舜平



(15)

(16)



第1頁の続き

⑦発明者 小柳 かおる 東京都世田谷区北烏山7丁目21番21号 株式会社半導体エ  
ネルギー研究所内  
⑦発明者 今任 慎二 東京都世田谷区北烏山7丁目21番21号 株式会社半導体エ  
ネルギー研究所内  
⑦発明者 山口 利治 東京都世田谷区北烏山7丁目21番21号 株式会社半導体エ  
ネルギー研究所内  
⑦発明者 坂間 光範 東京都世田谷区北烏山7丁目21番21号 株式会社半導体エ  
ネルギー研究所内  
⑦発明者 犬島喬 東京都世田谷区北烏山7丁目21番21号 株式会社半導体エ  
ネルギー研究所内